														[Τ				
Дубл.																					
Замість																					
Підпис																	<u> </u>				
Α	Цех	Діл													Позначення документу						
Б	Код.назва обладнання							СМ Проф			Р	УT	кр ковд			OH	ОП	К ШТ	т пз	ТШТ	
K-M	Назва деталі.скл одиниці або матеріалу							Позначення.код					oð			СПП	OB	OH	KB	H Bump	
01																					
02																					
03																					
04																					
A 05	402		12	050	402 12 050.Елек													0,0091			
0 06		Bunp	abum	ου δρακ παῦκυ (2) no ΤΤΠ 659-547 KE																	
07	2	Фот	о еле	мент по:	.1 (BL1) встанові	лшп на	плату з	гідно рис.8 КЕ	()i a	запаяг	חט חס	TTO 1	9-63	2							
08	3	Розє	м по:	3.13 (XS1)	встановити на	плату	згідно	puc.10 KE ()	запая	ımu no	o TTO	452-7	34								
09	4	Розє	м по:	3.14 (XS2	встановити на	ı n/amy	эгідно	puc.4 KE ()	запая	nu no	OTT o	687-75	55								
10	5	Розє	м по	3.15 (XS3	встановити на	ı n/ıamy	эгідно	puc.5 KE () i	запаяі	nu no	TTO	379-11	+								
T 11		Кусс	чки Г	T789 98	7 , Пінцет РТ987	789 ,	Паяльни	ık PT444 555													
K 12	2	Фот	о еле	мент СФ	B-464CdSe-1.5B													796	100	100	
13	13	Розє	м 21	14ПРОК	B02.012.010CK													796	100	100	
14	14	Розє	м 21	15ПРОК	302.012.010CK													796	100	100	
15	15	Розє	м 21	16ПРОК	302.012.010CK													796	100	100	
M 16		Приг	ιοῦ Π	ОСТ 61 Г	DCT 21921-76													180	100	1,32	
17		Флю	ФΚί	п гост	4866-54													180	100	1,32	
18		СБС	гост	5987-57														180	100	1,32	